





HP ProLiant DL160 G5 是一款基于机柜优化设计的高密度机架服务器,仅为 1U 的机箱外形,却具有极高的性能及扩展性。

DL160 G5 支持双路四核处理器, 高达32GB内存容量, 可支持4块3.5 英寸高性能、高可靠性的热插拔SAS或SATA 硬盘或高容量、高性价比的SATA 硬盘, 为用户提供了多种选择。

全新特性

HP ProLiant DL160 G5服务器采用全新的英特尔[®] 5400芯片组,搭配英特尔[®] 至强[®] 5400系列四核处理器, DDR2 667MHz全缓冲内存,全新的设计架构,使得这款服务器具有超强的处理能力,充分满足高负载运算环境的需求。全新的二代PCI-Ex16插槽,且支持256MB独立的图形显示卡。同时具有较好的管理特性,系统ID识别指示灯和Lights Out 100i远程管理卡,使得网管人员可以快捷的对系统进行维护和远程管理。

高性能

- 英特尔®至强® 5400系列处理器, 12MB (2X6MB)的 高速缓存, 最高 1600MHz 前端系统总线
- PC5300 DDR2-667 增强的 ECC 内存技术,最大支持 到 32GB,也支持内存交错存取技术,从而获得更高 的内存IO性能

- 可选 SA SC11Xe/SC44Ge/E200/E500/P400/ P800阵列卡
- 非热插拔型 1 个全长全高 PCI-E x 16 (2代), 1 个半高 PCI-Ex 16 (2代); 热插拔型 1 全长全高 PCI-Ex 16 (2代), 1 个半高 PCI-X, 均可转换
- 集成双路千兆以太网卡
- 可选加NCIDIA Quadro FX1500或FX3500 256MB PCIe图形显示卡

管理性

- 兼容IPMI 2.0
- 主板集成HP ProLiant Lights Out 100i 远程管理卡, 支持虚拟KVM和虚拟介质,实现全功能管理

全新设计

- 通用机架安装导轨
- 全新的机箱设计, 带有ID识别灯, 便于快捷维护
- 两个前置USB端口,一个内置USB端口,两个后置 USB端口



÷	\¥ nn								
·品编号 ————————————————————————————————————	说明								
‡热插拔串行ATA (SATA)机型									
445 198-AA 1	标配 1 个剪	标配 1 个英特尔®至强®四核处理器 X5472(3.00GHz, 120 瓦,1600 MHz FSB), 2GB PC2-5300 DDR2 全缓冲内存插槽(667MHz), 160GB NHP SAT							
		盘,机架安装式(1U)							
445 197-AA 1		标配 1 个英特尔®至强®四核处理器 E5430(2.66GHz, 80 瓦, 1333MHz FSB), 1GB PC2-5300 DDR2 全缓冲内存插槽(667MHz), 160GB NHP SATA							
	机架安装式(1U)								
445 196-AA1	标配 1 个英特尔®至强®四核处理器 E5405(2.00GHz, 80 瓦, 1333MHz FSB), 1GB PC2-5300 DDR2 全缓冲内存插槽(667MHz), 160GB NHP SATA 机架安装式(1U)								
th +手++- 由 <= ATA /C ATA\/ 由 <= C <i>C</i> C		文(10)							
热插拔串行 ATA (SATA) /串行 SCS 445204-AA1		ᅔᄹᄼᆥᇰᅎᄙᆥᇑᆉᄊᅖᅈᄫᄼᄱ	0/2 00CH- 120 E	1600 MH= ESD) 3)CB DC2 5200 DDB2 △經、	n n 左 任 博 / 6 6 7 M U	-) +0 加宁壮士/111		
445204-AA1		标配 1 个英特尔®至强®四核处理器 X5472(3.00GHz, 120 瓦, 1600 MHz FSB), 2GB PC2-5300 DDR2 全缓冲内存插槽(667MHz), 机架安装式(1U)							
445203-AA1		标配 1 个英特尔* 至强*四核处理器 E5430(2.66GHz, 80 瓦, 1333MHz FSB), 1GB PC2-5300 DDR2 全缓冲内存插槽(667MHz), 机架安装式(1U) 标配 1 个英特尔* 至强* 四核处理器 E5405(2.00GHz, 80 瓦, 1333MHz FSB), 1GB PC2-5300 DDR2 全缓冲内存插槽(667MHz), 机架安装式(1U)							
443202-AAT	标能!介 身	₹特尔 至強 四核处理器 E3403	5(2.00GHz, 80 瓦,	1333MHZ F3B), 1G	7B PC2-3300 DDR2 全場/円	列仔插懵(00/M⊓z) ,	,机架安装式(TU)		
标准配置									
处理器	英特尔®至强®四核处理器 X5472 (3.00GHz,120 瓦,1600MHz 前端总线)								
以下各项取决于产品机型)	英特尔®至	英特尔®至强®四核处理器 X5460 (3.16GHz, 120瓦,1333MHz 前端总线)*							
	英特尔®至	英特尔®至强®四核处理器 X5450 (3.00GHz, 120瓦,1333MHz 前端总线)*							
	英特尔®至强®四核处理器 E5430 (2.66GHz, 80 瓦,1333MHz 前端总线)								
		英特尔 [®] 至强 [®] 四核处理器 E5405 (2.00GHz, 80 瓦,1333MHz 前端总线)							
		*仅按订单配置。欲了解更多信息,请参见"工厂集成机型"部分。							
可升级性	可升级至对								
芯片组		英特尔® 5400芯片组							
高速缓存		6MB)二级高速缓存(5400序列)							
内存保护	高级 ECC:								
为存	类型 PC2-5300全缓冲内存插槽(DDR2-667)								
	标配	标配 1GB (2x512MB)							
	最大	最大 32GB (8x4GB)							
网络控制器	2个嵌入式	式NC320i PCle千兆服务器适配	2器						
广展插槽	插槽号	总线速度	总线号*	设备数量**	热插拔 (是/非)	PCI电压	注		
	1	x 16 PCI-Express Gen2	1	0	否	3.3 伏	全长,全高		
	1	PCI-X***	5	1	否	3.3 伏	全长,全高		
	2	x16 PCI-Express Gen2	6	3	否	3.3 伏	薄型		
	2	PCI-X***	5	1	否	3.3 伏	薄型		
	注 : 所有插槽均可支持通用PCI卡								
	* 默认总线分配。使用PCI网桥插入卡时,可能会改变实际的总线分配数量。								
	** 插槽数根据操作系统的不同而异。MS操作系统根据总线由低到高的顺序排列设备ID (以最低总线为起点进行排列)。								
	*** 安装-	一个PCI-X卡时,PCI-X总线速度	为 133MHz。安装	两个PCI-X卡时为 100)MHz。				
存储控制器	非热插拔 SATA 机型 支持 SW RAID 0、1 的惠普嵌入式 SATA RAID 控制器(集成到南桥芯片中)								
	热插拔 SA	热插拔 SATA/SAS 机型 支持 RAID 0、1的 HP SC40Ge HBA							
	注 :通过(注,通过CD安装Windows操作系统时,如要安装存储控制器,需要磁盘驱动器、USB软驱按键或虚拟FDD (使用LO100 精选软件包或高级软件包)							

标准配置						
	光驱	DVD-ROM 光驱	8 倍速 IDE (ATAPI) DVD-ROM 驱动器,小型(可选)			
		DVD/CD-RW 光驱	24 倍速 IDE (ATAPI) CD-ROM 光驱(可选)			
		磁盘驱动器	仅通过USB连接			
	驱动器托架	非热插拔 SATA	4个非热插拔SATA 3.5英寸驱动器			
		热插拔 SATA/SAS	4个热插拔SATA/SAS 3.5 英寸驱动器			
		非热插拔 SATA	4个非热插拔SATA 3.5英寸驱动器			
最大内部存储	非热插拔 SATA	2TB	4x500GB			
	热插拔 SATA	ЗТВ	4x750GB			
	非热插拔SAS	1.2TB	4x300GB			
	热插拔 SAS	1.2TB	4x300GB			
	并行端口	无				
	RJ-45 网络接口(以太网)	2个10/100/1000网卡端口	(外加 1 个 HP ProLiant Lights Out 100i 远程管理的专用端口)			
	串行端口	1	<u> </u>			
	定位设备(鼠标)	1				
	显卡	1				
	並下 	1				
	USB端口	5个(正面2个,内置1个,	皆面 2 个)			
	**		004.www1.hp.com/products/servers/platforms/usb-support.html。			
显卡	集成在系统板:	111	1 1 1 1			

	或					
	16bpp (位/像素)时 1024x768	或 2^16 = 65536 或 64k色				
外形	机架安装式(1U), (4.45厘米/	1.75英寸)				
独立的服务器管理软件 — Proliant E	Essentials					
ProLiant Essentials快速部署软件包	快速部署软件包(RDP)是面向所有 ProLiant 服务器的自动部署与配置解决方案。RDP 支持 100 系列服务器的图像捕获和配置。每个软件包光盘包括 10 节点试用许可,用于软件的评估。部署的每一台服务器需要 1 个 RDP 许可,与惠普服务器一起提供。欲知详情,请访问:http://www.hp.com/go/rdp。					
集成 Lights-Out 高级软件包	利用包括虚拟KVM远程图形控制台、增强的控制台共享和回复、虚拟介质(软驱、CD/DVD、USB密钥)、虚拟文件夹、企业安全(目录服务和双因素验证)的综合远程控制升级 ilO 2处理器。					
集成 Lights-Out 精选软件包	利用增强的控制台共享和回复、虚拟介质(软驱、CD/DVD、USB密钥)、虚拟文件夹、电源历史报告、功率封顶和企业安全(目录服务和双因素验证)升级 ilO 2 处理器,以便使用 ilO 2 标准和 ilO 2 标准刀片版本中的远程控制台管理服务器。					
Lights-Out 100i	HP Lights-Out 100i 远程管理为 ProLiant DL 100系列服务器提供经济适用、入门级别的远程管理功能。HP Lights-Out 100i 允许用户或其服务提供商在局域网或内部网络中远程管理 ProLiant DL100系列服务器。					
核心基础设施架构管理						
用户选择			预定服务,能够提供针对 Proliant 产品的软件和驱动程序变化通知。请在网站: 以便在出现各种新警报时能够按周或按月进行接收。			
ProLiant Support Packs软件 和ROMPaq软件		最新的软件、驱动程序和固件均已经过优化和测试,适用于您的ProLiant服务器和选件,它们包含在ProLiant Support Packs、ProLiant Essentials快速 部署软件包和SmartStart中,也可以通过软件和驱动程序下载页面进行下载,网址: http://www.hp.com/go/support 。				
工业标准符合性	符合 ACPI V2.0 标准					
	符合 PCI 2.2 标准					
	支持PXE					
	支持WOL					
	Microsoff®标识认证					
	符合 IPMI 2.0					
可管理性	SMASH CLP标准	工場 <i>化系统</i> 运和控制内坐				
	HP Lights-Out 100i标准提供以下操作系统远程控制功能。 • 虚拟电源					
	 ▼ 症状电源 ● 系统事件日志访问 					
	• 系统状态					
	• 远程串行控制台(串行重定向)					
	• 浏览器,Telnet访问					
	• 符合 SMASH-CLP 标准					
	13 11 11 11 11 11 11					

标准配置					
可管理性(续)	提供许可密钥的 HP Lights-Out 100i 精选软件包具有以下特性。 • 虚拟介质(软盘和CD) • 加密套接字协议层加密				
	 Secure Shell 加密 提供许可密钥的HP Lights-Out 100i高级软件包具有以下特性。 虚拟KVM (KVM over IP功能嵌入于系统板)以及所有LO100i精选软件包特性。 				
安全性	开机密码 设置密码				
服务器电源线	标配 1 根高压 IEC 电源线(用于连接到配电单元) 注:机架式机型标配 1 根 IEC 电缆。 世界其他地区特定机型附带的本地电缆。				
UPS和PDU 电源线表	欲了解UPS和PDU单元的电缆说明、要求和规格,请参阅UPS和PDU电源线说明: http://h18004.www1.hp.com/products/servers/proliantstorage/power-protection/index.html。				
电源	650 瓦,自动切换,PFC (功率因数校正) 注:为获得较低的总体拥有成本,工厂可升级到高效(HE)电源				
系统风扇	标配6个非热插拔、非冗余系统风扇				
操作系统支持	Microsoft Windows 2003和Microsoft Windows 2003/R2 Standard Edition (32-bit)				
	Microsoft Windows 2003和 Microsoft Windows 2003/R2 Enterprise Edition (32-bit)				
	Microsoft Windows 2003和Microsoft Windows 2003/R2 Web Edition (32-bit)				
	Microsoft Windows 2003和 Microsoft Windows 2003/R2 for Extended Systems Standard Edition (64-bit)				
	Microsoft Windows 2003和Microsoft Windows 2003/R2 for Extended Systems Enterprise Edition (64-bit)				
	Red Hat Enterprise Linux				
	SUSE Linux Enterprise Server Solaris 10				
	注:欲了解最新操作系统的支持列表,请参阅:http://www.hp.com/go/supportos				
	注: 欲了解适用于HP ProLiant DL160 G5 的最新驱动程序更新列表,请参阅: http://h18023.www1.hp.com/support/files/server/us/index.html。				
	注: 欲了解有关如何从惠普购买服务器操作系统的最新完整信息,请访问操作系统产品网站:				
	http://h18004.www1.hp.com/products/servers/software/OEM.html				
	注:基本介质将会为一些Linux操作系统提供驱动程序。在配置服务器时,请参阅您的基本介质驱动程序库,或访问惠普网站: http://h18023.www1.hp.com/support/files/server/us/index.html				
	注:欲了解有关Linux操作系统支持和认证的更多信息,请访问网站 http://h18004.www1.hp.com/products/servers/linux/hpLinuxcert.html 参阅 ProLiant与Bladesystem Server Linux列表				
机架气流要求	机架 10000 系列机柜				
	日益强大的全新高性能处理器技术要求机架安装式服务器具备更高的冷却效率。10000系列机架提供增强的气流,支持较大限度的冷却,使机架能够 满足配置最新处理器的服务器。				
	警告:如果使用第三方机架,请查看以下的附加要求,以确保有足够的气流,并防止损坏设备:				
	 前门和后门:如果您的42U服务器机架包括关闭的前后门,您必须将5350平方厘米(830平方英寸)的气孔从上到下平均分布在整个机架上,使机架 有足够的气流(即确保留有64%的开放区域用于通风)。 				
	 侧面:安装的机架组件和机架侧面板之间的间距至少应有7厘米(2.75英寸)。警告:始终使用空面板来填充机架中剩余的前面板U空间。这种布局可确保适当的气流通过。使用不带空面板的机架会导致散热不均,可能带来散热故障。 				
	注:欲了解更多信息,请参考《设置和安装指南》或随服务器提供的文档CD,或登录以下网址:www.hp.com/servers/dl160。				
Telco 机架支持	Telco 机架套件: 对所有双柱 Telco 机架的支持需要使用标准机架套件和机架解决方案提供的附加选件套件。 http://www.racksolutions.com/hp				
面向服务器和存储设备的 整套工厂快速响应	惠普工厂快速响应提供面向惠普服务器和存储产品的配置、定制、集成和部署服务。用户可以根据自己的需求来定制出厂设置、测试、集成、运输和 部署等工厂解决方案。				
	成套工厂快速响应服务可提供简单配置、装架、安装、复杂配置和设计服务以及个别工厂服务,如:映像加载、资产标签和定制包装等。惠普产品通 过工厂快速响应所支持的产品包括:HP Integrity 动能服务器、HP Proliant服务器、HP Proliant 刀片式服务器、HP BladeSystem 服务器、HP 9000 系列				
	服务器和MSA1000、VA7xxx、EVA、XP、机架安装式磁带库以及可配置的网络交换机等存储产品。				
	欲了解有关支持您具体服务器机型的工厂快速响应服务的更多信息,请与您的销售代表联系或访问:http://www.hp.com/go/factory-express。				
HP Enterprise Configurator	HP eCo-Enterprise Configurator 可以为惠普硬件组合提供工厂默认的机架。此方法符合我们的战略方向,能够满足客户的需求和期望。如果您需要"宽制"的机架配置,请与惠普客户业务中心或授权的合作伙伴联系,以寻求帮助。				

标准配置

服务与支持

此产品享受全球有限保修,并由惠普服务及全球惠普授权渠道合作伙伴网络提供支持。自购买之日起1年内提供硬件诊断支持和维修。自购买之日起90天内提供软件和首次安装支持。附加的支持可能包含在保修中,或者需要支付额外的费用。通过惠普金牌服务或定制的服务协议可获得增强保修服务

注:服务器保修包括3年部件、1年人工、1年现场支持以及下一工作日响应。欲了解有关全球有限保修和技术支持的其它信息,请访问: http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/warranty/index.html

注:欲了解有关全球有限保修和技术支持的其它信息,请访问:http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/warranty/index.html。 惠普金牌服务通过尽责响应提供全程助力和专业支持,满足您的IT和业务需求。

惠普金牌服务包括可同时或随后购买、机箱内置、适用于服务器的惠普品牌硬件选件,以及22英寸或更小的外置显示器和高达3kVA的立式UPS选件。这些选件包含与服务器相同的服务级别和覆盖期限。服务不包括UPS电池,采用标准保修条款与条件。对于安装在机架内的服务器或存储系统,服务还涵盖所有安装在同一机架内的惠普机架选件。

如要充分发挥 HP ProLiant 服务器性能并创造更大效益,需要一个完全了解您服务器技术和系统环境的合作伙伴。惠普服务是提供多种供应商支持解决方案的业界先锋,为满足各种业务需求提供一系列的专业支持服务。无论是中小型企业还是大型国际企业,惠普都有一套 ProLiant 服务器支持方案帮助其实现快速部署和系统运行时间的最大化。

推荐的服务 — 可简化ProLiant解决方案的实施、维护和管理流程。

- 支持服务 3年9x5下—工作日,不包括惠普假日
- 部署服务 仅限硬件安装

增强的服务 — 可提供更高的服务级别,以增强IT性能和可用性。

- 支持服务 3年 13x5 同一工作日, 4小时响应
- 部署服务 仅限安装和启动

根据客户说明和/或产品技术资料安装和启动ProLiant服务器和Microsoft或 Linux操作系统。周一至周五8:00 am到5:00 pm提供此服务,不包括惠普假日。

欲了解服务选项和信息的完整清单,请访问:

http://www.hp.com/services/proliantservices http://www.hp.com/go/proliant/carepack

配置信息 一工厂集成机型

步骤1:基本配置(选择以下任一款可配置的机型)

非热插拔机型

HP ProLiant DL160 G5 非热插拔 SATA 机架 CTO 机箱

445192-B21

工厂集成机型配置有

2个嵌入式NC105i PCIe千兆服务器适配器(符合WOL和PXE标准)

2个可用的PCI-Express Gen2插槽:

插槽1:全长/全高插槽2:薄型/半高

注:可选的PCI-X选件套件包括:插槽1:全长/全高PCI-X 100;插槽2:薄型/半高PCI-X 100。PCI-X插槽为64位;

服务器上仅安装一个PCI-X卡时,运行速度为133 MHz。

1个HP SATA/SAS 主机电缆套件

650 万.电源

1条高压IEC电源线

6个非热插拔风扇

机架式(1U), (4.45厘米/1.75英寸)

热插拔机型

HP ProLiant DL160 G5 热插拔 SATA/SAS 机架 CTO 机箱

445 193-B21

工厂集成机型配置有

2个嵌入式NC105i PCle千兆服务器适配器(符合WOL和PXE标准)

2个可用的PCI-Express Gen2插槽

插槽1:全长/全高

插槽2: 薄型/半高

注: 可选的PCI-X选件套件包括: 插槽 1: 全长/全高PCI-X 100; 插槽 2: 薄型/半高PCI-X 100。PCI-X插槽为64位;

服务器上仅安装一个PCI-X卡时,运行速度为133 MHz。

1个带有RAID功能的惠普内置8端口SAS主机总线适配器

1个热插拔背板选件套件

650 瓦电源

1条高压IEC电源线

6个非热插拔风扇

机架式(1U), (4.45厘米/1.75英寸)

配置信息 一 工厂集成机型				
步骤2:选择所需选件(除非另有注明	,否则只能从以下列表中选择一个)			
基础处理器	英特尔®至强®四核处理器 X5472 (3.00GHz,120 瓦,1600MHz 前端总线),FIO	448365-L21		
	注: 如果需要2个处理器,则 448365-L21 处理器和 448365-B21 处理器各选一个。			
	英特尔®至强®四核处理器X5460 (3.16GHz,120瓦,1333MHz 前端总线),FIO	446085-L21		
	注:如果需要2个处理器,则 446085-L21 处理器和 446085-B21 处理器各选一个。			
	英特尔®至强®四核处理器 X5450 (3.00GHz,120 瓦,1333MHz 前端总线),FIO	446081-L21		
	注:如果需要2个处理器,则 446081-121 处理器和 446081-B21 处理器各选一个。			
	英特尔®至强®四核处理器 E5430 (2.66GHz,80 瓦,1333 MHz 前端总线),FIO	446079-L21		
	注:如果需要2个处理器,则 446079-L21 处理器和446079-B21 处理器各选一个。			
	英特尔®至强®四核处理器 E5405 (2.00GHz,80 瓦,1333MHz 前端总线),FIO	446077-L21		
	注:如果需要2个处理器,则446077·L2处理器和446077·B21处理器各选一个。			
内存	1GB FBD PC2-5300 2x512套件			
	2GB FBD PC2-5300 2x1GB 套件,低功耗	46 1826-B2 1		
	2GB FBD PC2-5300 2x1GB套件	397411-B21		
	4GB FBD PC2-5300 2x2GB 套件,低功耗	46 1828-B2 1		
	4GB FBD PC2-5300 2x2GB套件	397413-B21		
	8GB FBD PC2-5300 2x4GB LP套件	466440-B21		
	8GB FBD PC2-5300 2x4GB套件	397415-B21		
硬盘驱动器	串行ATA (SATA)非热插拔硬盘驱动器(仅限与非热插拔CTO 机箱机型结合使用)			
	HP 160GB 1.5G SATA 7.2K NHP 3.5 英寸HDD	411275-B21		
	HP 250GB 1.5G SATA 7.2K NHP 3.5英寸HDD	411276-B21		
	HP 500GB 1.5G SATA 7.2K NHP 3.5英寸HDD,FIO*	404469-B21		
	* 仅工厂集成			
	串行ATA (SATA)热插拔硬盘驱动器(仅限与SATA/SAS 热插拔CTO 机箱机型结合使用)	349238-B21		
	HP 160GB SATA 7.2K热插拔3.5英寸HDD			
	HP 250GB SATA 7.2K热插拔3.5英寸HDD			
	HP 500GB SATA 7.2K热插拔3.5英寸HDD			
	HP 750GB SATA 7.2K 热插拔 3.5 英寸 HDD 中に SCSI (SAS) 地 活化 連 和 原 計 架 (7 原 上 SATA / SAS 地 括比 CTO			
	串行SCSI (SAS)热插拔硬盘驱动器(仅限与SATA/SAS热插拔CTO机箱机型结合使用)			
	注:需要1个SAS HBA或阵列控制器。	375868-B21		
	HP 36GB 3G SAS 15K 3.5英寸SP HDD			
	HP 72GB 3G SAS 15K 3.5英寸SP HDD			
	HP 146GB 3G SAS 15K 3.5英寸SP HDD			
	HP 300GB 3G SAS 15K 3.5英寸SP HDD	43 1944-B2 1 435 129-B2 1		
存储控制器	惠普智能阵列 E500/256MB 控制器(标准 RAID 0、1、1+0)			
	256MB 电池支持的高速缓存写入升级支持 RAID 5	383280-B21		
	注:安装电池支持的高速缓存写入模块时,惠普智能阵列E500必须安装在全长PCI插槽中	411E00 D01		
	惠普智能阵列 E200/128 BBWC控制器	411508-B21 449363-B21		
	HP SC40Ge 4内置 PCIe SAS RAID 半高 HBA,FIO			
	HP SC44Ge主机总线适配器	416096-B21		
电源	惠普高效电源 1200 瓦套件,FIO.	453650-B21		
	惠普电源背板,FIO	453652-B21		
步骤3:为工厂集成选择其它选件	注:欲了解其它选件,请参阅以下"选件"部分。一些选件可能不适合工厂集成。请联系惠普销售代表获取更多信息。			
选件				
处理器	英特尔®至强®四核处理器X5472 (3.00GHz,120瓦,1600MHz 前端总线)选件套件	448365-B21		
	英特尔®至强®四核处理器 X5460 (3.16GHz,120 瓦,1333MHz 前端总线)选件套件			
	英特尔®至强®四核处理器 X5450 (3.00GHz,120 瓦,1333 MHz 前端总线)选件套件			
	英特尔®至强®四核处理器 E5430 (2.66GHz,80 瓦,1333MHz 前端总线)选件套件			
	英特尔®至强®四核处理器 E5405 (2.00GHz,80 瓦,1333MHz 前端总线)选件套件	446077-B21		
内存(FBDIMM)	1GB FBD PC2-5300 2x512套件	397409-B21		
	2GB FBD PC2-5300 2x1GB 套件,低功耗	46 1826-B2 1		
	2GB FBD PC2-5300 2x1GB套件	397411-B21		
	4GB FBD PC2-5300 2x2GB套件,低功耗	46 1828-B2 1		
	4GB FBD PC2-5300 2x2GB套件	397413-B21		
	8GB FBD PC2-5300 2x4GB LP套件	466440-B21		
	8GB FBD PC2-5300 2x4GB套件	397415-B21		

选件							
	中仁 VIV (CVIV) 라 찬 托45년 교회						
硬盘驱动器	串行ATA (SATA)非热插拔硬盘9				411275-B2		
	HP 160GB 1.5G SATA 7.2K NI				411275-B2		
		HP 250GB 1.5G SATA 7.2K NHP 3.5英寸HDD					
		串行ATA (SATA)热插拔硬盘驱动器(仅用于 SATA/SAS 热插拔机型)					
		注:需要1个SAS HBA或阵列控制器。 ————————————————————————————————————					
		HP 160GB SATA 7.2K热插拔3.5英寸HDD					
		HP 250GB SATA 7.2K热插拔3.5英寸HDD					
		HP 500GB SATA 7.2K热插拔3.5英寸HDD					
		HP 750GB SATA 7.2K热插拔3.5英寸HDD					
		串行 SCSI (SAS)热插拔硬盘驱动器(仅用于 SATA/SAS 热插拔机型) HP 36GB 3G SAS 15K 3.5 英寸 SP HDD					
		HP 36GB 3G SAS 15K 3.5英寸SP HDD					
		HP 72GB 3G SAS 15K 3.5英寸DP HDD					
		HP 72GB 3G SAS 15K 3.5英寸SP HDD					
	HP 146GB 3G SAS 15K 3.5英	HP 146GB 3G SAS 15K 3.5英寸DP HDD					
	HP 146GB 3G SAS 15K 3.5英	寸SP HDD			375872-B2		
	HP 300GB 3G SAS 15K 3.5英	寸DP HDD			416127-B2		
	HP 300GB 3G SAS 15K 3.5英	寸SP HDD			43 1944-B2		
	注:需要购买SAS HBA或阵列	控制器。					
光驱	DVD-ROM 光驱(可选)				447889-B2		
	DVD/CD RW 光驱(可选)				447891-B2		
技术规格							
系统设备	外形尺寸(高×宽×长) (带支架)	4.32x44.80x68.20厘米(1.70x	17.64x26.85 英寸)				
	重量(近似值)	最大(所有已安装的硬盘驱动器	电源和处理器)	16.78 千克(37.00 磅)			
		最小(已安装的1个硬盘驱动器、	电源和处理器)	13.69千克(30.00磅)			
	输入要求 (每个电源)	额定线电压	90到 140 伏交流电/1	80到 264 伏交流电			
		额定输入电流	7.31 安(115 伏交流电)	, 3.6 安(230 伏交流电)			
		额定输入频率	47到63赫兹				
		额定输入功率	855 瓦(100 伏交流电)	, 840.72 瓦(200 伏交流电)			
		要查阅典型系统功率额定值,请使用 Active Answers Power Calculator,它可通过以下网址获					
	<u> </u>	http://h30099.www3.hp.com/configurator/calc/Power%20Calculator%20Catalog.xls					
		- 点击您感兴趣的系统。例如:	DL380 G5	-			
		- 按照屏幕上的说明操作。					
	电源输出功率(每个电源)	额定稳定状态功率	653.10瓦(100伏交流	电), 653.08瓦(200伏交流电)			
	系统温度	工作	海平面温度为 10°C到	35°C (50°F到95°F), 每上升305米(1000英尺),	温度降低		
			1.0°C (1.8°F), 最大海拔高度为3050米(10000英尺), 避免持续阳光直射。最大				
			变化值为 10°C/小时(18°F/小时)最大值取决于安装的选件的类型和数量。		量。		
				者温度高于30°C (86°F),系统性能可能会降低。			
		非工作时		40° F), 最大变化值为20°C/小时(36°F/小时)。			
	相对湿度(无凝结)	工作	10%到85%相对湿度((Rh), 28°C (82.4°F)最大湿球温度,无凝结。			
		非工作时 10%到95%相对湿度(Rh), 38.7℃ (101.7°F)最大湿球温		(Rh), 38.7℃ (101.7°F)最大湿球温度,无凝结。			
	高度	工作 3050米(10000英尺)。该值取决于安装的选件			大高度变化值为		
			457米/分(1500英尺/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		非工作时	9144米(30000英尺)。允许的最大高度变化值为457米/分(1500英尺/分)。				
	噪音	下面列出的是产品在 23°C温度下工作时,已公告的A-Weighted 声功率水平(LWAd)以及已公告的3 Weighted 声压水平(LpAm)。噪音排放情况依照 ISO 7779 (ECMA 74)进行测定,并依照 ISO 9296 (I					
		空闲	LWAd	6.86			
			LpAm	52.36dBA			
		工作	LWAd	6.89			
			LpAm	52.60dBA			

欲了解惠普更多信息,请电话垂询

惠普售前支持热线: 800-820-2255 惠普售后支持热线: 800-810-3888 惠普客户反馈/投诉热线: 800-810-0039

或请访问: www.hp.com.cr

www.hp.com.cn/partner

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本文所含信息如有更改,恕不另行通知。惠普产品与服务的全部保修条款在此类产品和服务附带的保修声明中均已列明,本文中的任何信息均不构成额外的保修条款。惠普对于本文中所包含的技术或编辑错误、遗漏概不负责。Microsoft、Windows 和Windows NT 是微软公司在美国的注册商标。Intel 是 Intel Corporation 在美国的注册商标。所有信息的最终解释权归中国惠普有限公司所有

P/N: PMGC071205630CHP, 2008年1月中国印刷

